

# 第46期 中間報告書

2023年4月1日から2023年9月30日まで

京都発 → 世界へ

## 株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第46期中間報告書（2023年4月1日から2023年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、欧米によるインフレ抑制に向けた金融引き締めの継続やゼロコロナ政策解除後の中国経済の回復遅れなどにより、先行き不透明な状況が続きました。

半導体業界につきましては、PCやスマートフォンなどの最終製品需要の低迷が長引くものの、車載用半導体やパワー半導体は安定した需要が継続しました。また、生成AIの普及により、超広帯域メモリ（HBM：High Bandwidth Memory）などサーバー向け投資が増加しており、今後も継続的な投資が期待されます。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の当社グループの業績は、車載用半導体向けモールドング装置・金型の売上が好調に推移しているものの、PCやスマートフォンなど民生品向けの売上が低調であったことから、売上高は212億65百万円（前年同期比75億18百万円、26.1%減）、対前年同期比で減収となりました。また、利益につきましては、売上高の減少に伴い、営業利益23億88百万円（前年同期比34億74百万円、59.3%減）、経常利益27億63百万円（前年同期比37億26百万円、57.4%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益19億58百万円（前年同期比28億9百万円、58.9%減）となり、各段階利益は対前年同期比で減益となりました。

一方、対予想比では売上高は概ね予想通りとなったものの、高付加価値製品の増加にともない粗利益率が改善した結果、各段階利益は予想値を上回りました。また、受注につきましては、東南アジア地域における車載用半導体増産に向けた投資や生成AI向けHBMの増産に向けた投資が増加したことから、当第2四半期連結累計期間の受注高は268億60百万円（前年同期比15億96百万円、6.3%増）となり、当第2四半期末における受注残高は346億62百万円となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり40円を予定しております。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、

グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2023年12月



代表取締役社長

岡田博和

## 連結財務諸表

### ● 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科 目	当第2四半期末 2023年9月30日現在	前期末 2023年3月31日現在
<b>【 資 産 の 部 】</b>		
流 動 資 産	47,531	45,960
現金及び預金	18,372	16,547
受取手形及び売掛金	11,350	11,766
電子記録債権	224	1,201
棚卸資産	16,387	15,407
その他の資産	1,196	1,037
固 定 資 産	29,055	27,508
有形固定資産	22,068	21,359
建物及び構築物	8,973	8,691
土地	5,276	5,205
その他の資産	7,818	7,462
無形固定資産	1,345	1,162
投資その他の資産	5,640	4,986
資産合計	76,586	73,468
<b>【負債及び純資産の部】</b>		
流 動 負 債	21,089	19,747
支払手形及び買掛金	2,819	2,411
電子記録債務	68	46
短期借入金	9,900	9,400
一年以上返済予定長期借入金	1,810	1,930
その他の負債	6,491	5,959
固 定 負 債	5,393	6,097
長期借入金	3,100	3,950
その他の負債	2,293	2,147
負債合計	26,483	25,845
株 主 資 本	43,167	42,318
資本金	8,955	8,942
資本剰余金	450	472
利益剰余金	33,874	32,916
自己株式	△ 113	△ 13
その他の包括利益累計額	6,936	4,903
非支配株主持分	—	401
純資産合計	50,103	47,623
負債・純資産合計	76,586	73,468

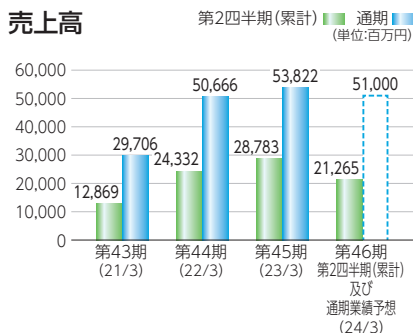
### ● 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

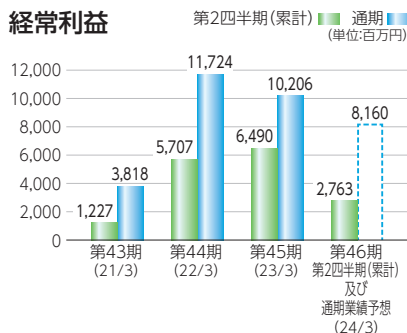
科 目	当第2四半期(累計) 2023年4月1日から 2023年9月30日まで	前第2四半期(累計) 2022年4月1日から 2022年9月30日まで
売 上 高	21,265	28,783
売 上 原 価	14,399	18,594
売 上 総 利 益	6,865	10,188
販売費及び一般管理費	4,477	4,325
営 業 利 益	2,388	5,863
営 業 外 収 益	432	688
営 業 外 費 用	58	61
経 常 利 益	2,763	6,490
特 別 利 益	1	0
特 別 損 失	2	11
税金等調整前四半期純利益	2,762	6,479
法 人 税 等	803	1,702
四 半 期 純 利 益	1,958	4,777
非支配株主に帰属する四半期純利益	—	8
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,958	4,768

## 連結財務ハイライト

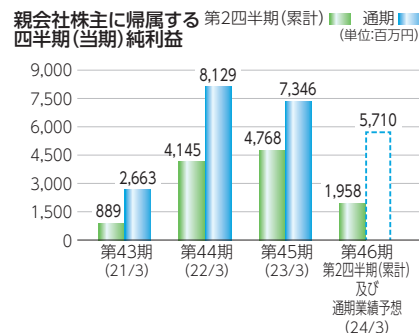
### 売上高



### 経常利益



### 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



## TOWA Technology Exhibitionの開催

2023年9月25日から、当社マレーシア工場において、TOWA Technology Exhibitionを開催いたしました。10月20日までの開催期間中に、お客様や取引先など計30社、129名の方にご来場いただき、盛況のうちに終えることができました。

近年、東南アジア地域において関連の設備投資が加速しており、同地域への半導体メーカー各社の積極的な投資は今後も続くことが予想される中、半導体メーカー各社を含むステークホルダーとの関係を一層強固なものとするべく、引き続き営業活動に励んでまいります。



## 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定

当社は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が共同で算出する「JPX日経中小型株指数」の2023年度（2023年8月31日～2024年8月29日）の構成銘柄として選定されました。今後も皆さまのご期待にお応えできるよう、さらなる成長と企業価値向上を目指してまいります。



## TOWAのキャラクター「トワッピー」誕生

当社は、長期ビジョン実現に向けて、採用などの人材確保や、BtoCを視野に入れた新たな事業展開を見据えて、キャラクター「トワッピー」を制作いたしました。また、「トワッピー」の誕生に併せて、当社を多くの方々に知っていただけるよう、本社工場に企業広告看板を設置いたしました。



## 会社の概要 (2023年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,955,671,632円
本社所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	632名(単体) 1,977名(連結)
ホームページ	<a href="https://www.towajapan.co.jp">https://www.towajapan.co.jp</a>
上場取引所	東京証券取引所プライム市場

役員	代表取締役社長	岡田博和
	取締役常務執行役員	石田耕一
	取締役上席執行役員	柴原信隆
	取締役執行役員	西村一洋
	取締役執行役員	三浦宗男
	取締役常勤監査等委員	蒲生喜代重
	社外取締役監査等委員	和氣大輔
	社外取締役監査等委員	後藤美穂
	社外取締役監査等委員	田中素子
	上席執行役員	早坂昇
	上席執行役員	鈕方舜
	上席執行役員	韓相倫
	執行役員	笹田秀典
	執行役員	中西和彦

## 株式の状況 (2023年9月30日現在)

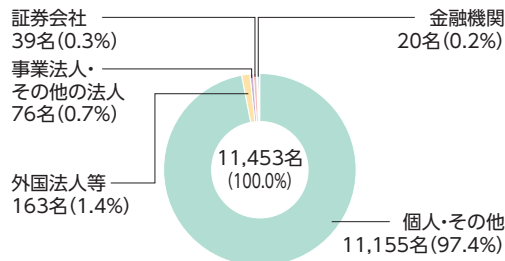
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,043,888株
- 株主数 11,453名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
株式会社日本カストディ銀行	3,297千株	13.17%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	3,261	13.03
株式会社ケイビー恒産	2,000	7.99
株式会社エヌレガロ	1,400	5.59
GOVERNMENT OF NORWAY	772	3.09
株式会社京都銀行	699	2.80
野村証券株式会社	461	1.85
K I A F U N D 1 3 6	450	1.80
T O W A 社 員 持 株 会	393	1.57
野村信託銀行株式会社	347	1.39

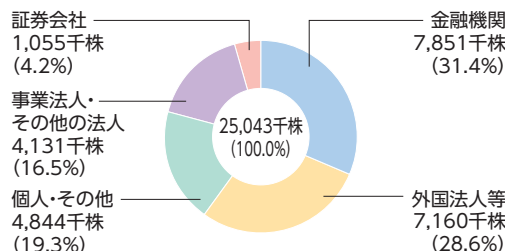
(注1) 株式会社日本カストディ銀行、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び野村信託銀行株式会社の持株数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(13,959株)を控除して計算しております。

### 所有者別株主数分布



### 所有者別株式数分布



## TOWAグループ (2023年9月30日現在)

### 国内

TOWA株式会社  
 本社・工場 京都東事業所  
 九州事業所 長野営業所

株式会社バンディック  
 TOWATEC株式会社  
 TOWAレーザーフロント株式会社

### 海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)  
 TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)  
 TOWA TOOL SDN. BHD. (マレーシア)  
 TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp. (フィリピン)  
 TOWA THAI COMPANY LIMITED (タイ)  
 TOWA USA Corporation (米国)  
 TOWA Europe B.V. (オランダ)  
 TOWA Europe GmbH (ドイツ)

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)  
 東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)  
 東和半導体設備(南通)有限公司 (中国)  
 東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司 (中国)  
 台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)  
 TOWA韓国株式会社 (韓国)  
 TOWAファイン株式会社 (韓国)

## 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会 毎年6月

基準日 株主総会権利行使及び期末配当 3月31日  
 中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び  
 電話お問合せ先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

株主総会資料の電子提供制度(書  
 面交付請求)についての問合せ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
 ☎0120-524-324 (電子提供制度専用フリーダイヤル)

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行本店及び全国各支店  
 みずほ銀行本店及び全国各支店

公告方法 電子公告(<https://www.towajapan.co.jp>)  
 ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。